

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-072

深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同兴达”）于2021年9月30日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，并提交公司股东大会审议。

经审议，董事会认为本次对外投资设立全资子公司符合公司的战略发展规划，如能顺利实施，将会对公司整体实力和综合竞争力的提升产生影响，有利于公司的长远发展。本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-071）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

二、审议并通过了《公司关于签订项目合作框架协议的议案》

经审议，董事会同意公司与日月光半导体（昆山）有限公司签订项目合作框架协议。按照项目总投资金额，双方共同出资，合作“芯片先进封测（Gold Bump）全流程封装测试项目”。实现优势互补，提升公司的盈利能力，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2021-070）。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

三、审议并通过了《公司关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月1日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日